Wykład VI Deep Level Transient Spectroscopy

Defekty

Podział: punktowe i rozciągłe

Punktowe: zlokalizowane przestrzennie, oddziałują z najbliższymi sąsiadami. Dzielą się na samoistne (np. wakanse, atomy w międzywęźlach) i niesamoistne (np. atomy domieszek w miejscu rodzimych atomów lub w międzywęźlach). Kompleksy jak np. dwuwakanse, kompleksy wakansdomieszka, vakans-donor są zwykle defektami punktowymi. Defekty rozciągłe są to np. granice ziaren, dyslokacje, stany powierzchniowe na interfejsach.



Płytkie poziomy domieszkowe

Płytkie akceptory i donory – głównie wynik domieszek podstawieniowych z sąsiedniej grupy układu okresowego, opisywane w przybliżeniu masy efektywnej (zwane również przybliżeniem atomu wodoru). W przypadku domieszek donorowych

$$E_{d} = \frac{m^{*}/m_{0}e^{4}}{\varepsilon_{s}^{2}} 13.6 \ eV \qquad a_{B}^{*} = \frac{m_{0}\varepsilon_{s}}{m^{*}} 0.53 \text{\AA}$$

Np. dla GaAs $a_B^* \cong 103$ Å a stała sieciowa jest rzędu 5.654 Å, zatem układ związany ładunek–domieszka obejmuje bardzo dużo komórek sieciowych. Dlatego przybliżenie masy efektywnej jest uzasadnione.

Dla domieszek akceptorowych sytuacja jest bardziej skomplikowana. Np. w związkach III-V, ze względu na degenerację pasma walencyjnego wyrażenie na efektywny promień Bohra zawiera parametr Luttingera γ_1 , który opisuje zależność E(k) dla dziur

$$a_B^* = \frac{4\pi\varepsilon_s\hbar^2\gamma_1}{e^2m_h^*}$$

Głębokie poziomy domieszkowe

Wszystkie poziomy domieszkowe, których nie da się opisać w przybliżeniu masy efektywnej to głębokie poziomy domieszkowe. Potencjał tych domieszek jest krótko-zasięgowy w odróżnieniu od długo-zasięgowego potencjału Coulomba płytkich domieszek. Obejmuje najwyżej jedną do kilku komórek elementarnych. W tej sytuacji periodyczna struktura kryształu nie ma wpływu na głębokie poziomy domieszkowe. Dlatego w rozważaniach teoretycznych obok potencjału domieszki należy uwzględnić potencjał krystaliczny ale często można go potraktować jako zaburzenie. Natomiast natura chemiczna jest istotna. Ze względu na trudności w identyfikacji źródła pochodzenia głębokich poziomów, często rozpoznaje się je podając energię aktywacji.



Płytkie i głębokie poziomy domieszkowe na diagramie pasmowym w przestrzeni rzeczywistej i w przestrzeni pędu

Głębokie poziomy domieszkowe

- "Głębokie poziomy domieszkowe" = stany z reguły w przerwie wzbronionej półprzewodnika, energia wiązania > 100 meV (jeśli nie, to są to płytkie poziomy)
- Generują je zarówno defekty punktowe jak i rozciągłe
- Terminologia: akceptoro-podobne (stan ładunkowy / 0), donoro-podobne (0 / +), podwójne akceptory (-- / / 0), podwójne donory (0 / + / ++), amfoteryczne (- / 0 / +) etc. Stan ładunkowy decyduje o przekroju czynnym na wychwyt elektronów i dziur, ale nie decyduje o położeniu poziomu w przerwie wzbronionej!
- Górna połowa przerwy wzbronionej: pułapki elektronowe, dolna dziurowe



Głębokie poziomy pułapkowe



a) Wychwyt elektronu; c_n - szybkość wychwytu elektronów [cm^3/s]

- b) Emisja elektronu; e_n szybkość emisji elektronów [1/s]
- c) Wychwyt dziury; c_p szybkość wychwytu dziur [cm^3/s]
- d) Emisja dziury; e_p szybkość emisji dziur

Proces a) i c) – centrum rekombinacji;

Proces b) i d) – centrum generacji;

Proces a) po którym następuje proces b) lub proces c) po którym następuje proces d) - centrum pułapkowe.

Równanie kinetyczne

• Zmiana czasowa stanu obsadzenia pasma przewodnictwa elektronami:



$$\frac{dn}{dt}|_{G-R} = (b) - (a) = e_n n_T - c_n n_T$$
^(a)

 N_T - koncentracja pułapek na poziomie E_T , n_T / p_T - koncentracja pułapek obsadzonych elektronami /dziurami i $N_T = n_T + p_T$.

 $c_n = \sigma_n v_{th}$ gdzie $\sigma_n [cm^2]$ - przekrój czynny na wychwyt elektronów, v_{th} - prędkość termiczna elektronów.

• Zmiana czasowa stanu obsadzenia pasma walencyjnego dziurami: $\frac{dp}{dt}|_{G-R} = (d) - (c) = e_p p_T - c_p p n_T$

Równanie kinetyczne

Zmiana czasowa stanu obsadzenia elektronami poziomu pułapkowego:

$$\frac{dn_T}{dt}|_{G-R} = \frac{dp}{dt} - \frac{dn}{dt} = (c_n n + e_p)(N_T - n_T) - (c_p p + e_n)n_T \quad *$$

Zakładamy, że w obszarze zubożonym można pominąć *n* i *p* (złącze spolaryzowane w kierunku zaporowym) oraz, że w obszarze kwazineutralnym *n* i *p* są stałe. Rozwiązanie równania * przy tym ostatnim założ.:

$$n_T(t) = n_T(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \frac{(e_p + c_n n)N_T}{e_n + c_n n + e_p + c_p p} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

$$\tau = 1/(e_n + c_n n + e_p + c_p p)$$

 $n_T(0)$ jest koncentracją obsadzonych pułapek w t = 0.

Dla
$$\boldsymbol{t} \to \infty$$
 $n_T = \frac{e_p + c_n n}{e_n + c_n n + e_p + c_p p} N_T$

Równanie kinetyczne

$$n_T(t) = n_T(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) + \frac{(e_p + c_n n)N_T}{e_n + c_n n + e_p + c_p p} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\right)$$

Dla półprzewodnika typu n można zaniedbać p:

$$n_T(t) = n_T(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right) + \frac{(e_p + c_n n)N_T}{e_n + c_n n + e_p} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau_1}\right)\right)$$
$$\tau_1 = 1/(e_n + c_n n + e_p).$$

Dalej, zakładając, że mamy pułapkę elektronową $e_n \gg e_p$ oraz zakładając, że dominuje proces emisji ($c_n = 0$), otrzymujemy:

$$n_T(t) = n_T(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau_e}\right) \approx N_T \exp\left(-\frac{t}{\tau_e}\right)$$

 $\tau_e = 1/e_n$

Zasada równowagi szczegółowej



Podstawiając ostatnie równania do równania *, otrzymujemy

$$e_{no} = c_{no}n_i \exp((E_T - E_i)/kT) = c_{no}n_1$$

Analogicznie dla dziur: $e_{p0} = c_{p0}p_1$

Zasada równowagi szczegółowej

Z kolei zakładamy, że współczynniki emisji i pułapkowania są takie same przy braku równowagi jak i w stanie równowagi:

$$e_{n} = c_{n}n_{1}; \qquad e_{p} = c_{p}p_{1} \qquad v_{th} = \sqrt{\frac{3kT}{m_{n}}}$$

$$e_{n} = 1/\tau_{e} \qquad c_{n} = \sigma_{n}v_{th} \qquad p_{1} = n_{i}\exp(-(E_{T} - E_{i})/kT)$$

$$r_{e} = \frac{\exp((E_{i} - E_{T})/kT)}{\sigma_{n}v_{th}n_{i}}; \qquad n_{i} = N_{c}e^{-(E_{c} - E_{i})/kT}; \qquad N_{c} = 2\left(\frac{2\pi m_{n}kT}{h^{2}}\right)^{3/2}$$

$$r_{e} = \frac{\exp((E_{c} - E_{T})/kT)}{\sigma_{n}v_{th}N_{c}} \qquad \tau_{e}T^{2} = \frac{\exp((E_{c} - E_{T})/kT)}{\gamma_{n}\sigma_{n}}$$

gdzie $\gamma_n = (v_{th}/T^{1/2})(N_c/T^{3/2}) = 3.25 \times 10^{21}(m_n/m_o) \text{ cm}^{-2}\text{s}^{-1}\text{K}^{-2}$



Physics and Devices, ed. Mac Graw Hill



Złącze Schottky'ego metal-półprzewodnik typu n



Dla złącza p^+n ($N_a \gg N_d$) lub metal-półprz. typu n:

dla polaryzacji w kier. przewodzenia:

dla polaryzacji zaporowej:

$$C = \frac{A}{2} \left[\frac{2q\varepsilon_0 \varepsilon N_d}{(V_0 + V)} \right]^{1/2}$$

$$C = \frac{A}{2} \left[\frac{2q\varepsilon_0 \varepsilon N_d}{(V_0 - V)} \right]^{1/2}$$

Pojemność złącza Schottky'ego metalpółprzewodnik typu n z pułapkami

$$C = \frac{A}{2} \left[\frac{2e\varepsilon_0 \varepsilon N_{scr}}{(V_{bi} + V_R)} \right]^{1/2}$$

 $N_{scr} = N_D^+ - n_T^-$ gdy w obszarze zubożonym są głębokie poziomy akceptorowe, obsadzone elektronami. Gdy są obsadzone dziurami – wtedy $N_{scr} = N_D^+$, bo akceptory są wówczas neutralne. Gdy w obszarze zubożonym są głębokie poziomy donorowe zajęte elektronami, to również $N_{scr} = N_D^+$, a gdy zajęte przez dziury to $N_{scr} = N_D^+ + p_T^+$.

Jeśli obsadzenie głębokich poziomów $n_T(t)$ lub $p_T(t)$ się zmienia, to pojemność również zmienia się w czasie. Dla głębokiego poziomu akceptorowego:

$$C(t) = \frac{A}{2} \left[\frac{2e\varepsilon_0 \varepsilon N_D}{(V_{bi} + V)} \right]^{1/2} \left[1 - \frac{n_T(t)}{N_D} \right]^{1/2} = C_0 \left[1 - \frac{n_T(t)}{N_D} \right]^{1/2} \approx C_0 \left(1 - \frac{n_T(t)}{2N_D} \right)^{1/2}$$

gdzie C_0 - pojemność złącza przy polaryzacji zaporowej (por. rys. na kolejnym slajdzie) i przy założeniu, że $N_T \ll N_D$, po rozłożeniu C(t) w szereg Taylora. Zależność C(t) zawiera informację o obsadzeniu głębokich poziomów.

Podsumowanie

Zależność C(t) zawiera informację o obsadzeniu głębokich poziomów pułapkowych:

$$C(t) \approx C_0 (1 - \frac{n_T(t)}{2N_D})$$

$$n_T(t) = n_T(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau_e}\right) \approx N_T \exp\left(-\frac{t}{\tau_e}\right)$$

$$\tau_e T^2 = \frac{\exp((E_c - E_T)/kT)}{\gamma_n \sigma_n} \qquad e_n / T^2 = \gamma_n \sigma_n \exp(-\frac{E_c - E_t}{kT})$$

Zatem szybkość emisji e_n oraz koncentracja głębokich poziomów mogą być wyznaczone na postawie pomiarów kinetyki pojemności złącza.

Zmiana obsadzenia głębokiego poziomu w złączu Schottky'ego metal – półprzewodnik typu n

- Dioda spolaryzowana w kierunku zaporowym
- Przykładany jest impuls depolaryzujący pułapki zapełniają się nośnikami. Szerokość obszaru zubożonego zmniejsza się, pojemność rośnie.
- Powrót do polaryzacji zaporowej.
 Ładunek + zjonizowanych donorów jest kompensowany elektronami na poziomach pułapkowych, szerokość obszaru zubożonego większa niż wyjściowo i pojemność też mniejsza od wyjściowej.
- Emisja nośników z poziomów pułapkowych.

$$\mathbf{C(t)} \approx C_0 \left(1 - \frac{n_T(t)}{2N_D} \right)$$

$$\Delta C_e(t) = C_0 - C(t) = \frac{C_0}{2N_D} n_T(0) \exp(-e_n t)$$





Zmiana pojemności - nośniki większościowe (złącze p-n, Schottky'ego, MOS)

1. $N_{scr} = N_D^+$ - w obszarze zubożonym są głębokie poziomy akceptorowe, nie obsadzone elektronami.

2. Impuls zapełniający – obszar zubożony węższy, C rośnie. Elektrony zapełniają głębokie poziomy akceptorowe.

3. Powrót do V_r . C maleje ale do mniejszej wartości niż wyjściowa. Gdy w obszarze zubożonym są głębokie poziomy akceptorowe, obsadzone elektronami wtedy $N_{scr} = N_D^+ - n_T^-$.

4. Emisja elektronów – C(t) rośnie do wyjściowej wartości.

$$C(t) \approx C_0(1-\frac{n_T(t)}{2N_D})$$



C(t) – idea pomiaru DLTS



Zmiana pojemności - nośniki mniejszościowe (złącze p-n)

1. $N_{scr} = N_D^+ - n_T^-$ gdy w obszarze zubożonym są głębokie poziomy akceptorowe, obsadzone elektronami.

2. Impuls zapełniający – obszar zubożony węższy, C rośnie. Dziury zapełniają głębokie poziomy akceptorowe.

3. Powrót do V_r . C maleje ale do większej wartości niż wyjściowa. Gdy w obszarze zubożonym są głębokie poziomy akceptorowe, obsadzone dziurami wtedy $N_{scr} = N_D^+$, bo akceptory są wówczas neutralne.

4. Emisja dziur – C(t) spada do wyjściowej wartości.

$$C = \frac{A}{2} \left[\frac{2e\varepsilon_0 \varepsilon N_{scr}}{(V_{bi} + V_R)} \right]^{1/2}$$



Zmiana obsadzenia głębokiego poziomu w złączu Schottky'ego



W obszarze o szerokości λ (długość Debay'a), następuje pułapkowanie elektronów:

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s \varepsilon_0}{eN_D} (E_F - E_T)}$$

Wówczas zależność C(t) nie jest już wykładnicza. Dlatego pomiary C(T) należy wykonywać przy takiej polaryzacji, aby

 $W \gg \lambda$

Technika DLTS

- Do złącza przykładany jest impuls napięciowy, który zmienia obsadzenie głębokiego poziomu. Dla pułapek większościowych depolaryzujący złącze wyjściowo spolaryzowane zaporowo, dla mniejszościowych – polaryzujący w kierunku przewodzenia (tylko dla złącza p-n).
- Pojemność zmienia się na skutek emisji nośników z głębokich poziomów.
- Szybkość emisji zależy od temperatury i energii aktywacji termicznej pułapki:

$$e_n/T^2 = \gamma_n \sigma_n \exp(-\frac{E_c - E_t}{kT})$$





D.K.Schroder "Semiconductor material and device characterization" ed. J.Wiley&Sons, (1998)

DLTS

W DLTS do próbki przykładany jest nie jeden ale ciąg periodycznych impulsów. To umożliwia stosowanie technik fazoczułych (woltomierz lock-in) do analizy kinetyk relaksacji pojemności złącza.

Jak ze zmiany pojemności uzyskuje się informację o szybkości emisji?



Spektroskopia niestacjonarnej pojemności DLTS metoda box-car

Pomiar pojemności w dwóch punktach C(t) w funkcji temperatury:

C(+)

C(+)

$$\delta C = C(t_1) - C(t_2) = \frac{n_T(0)}{2N_D} C_0 \left(\exp\left(-\frac{t_2}{\tau_e}\right) - \exp\left(-\frac{t_1}{\tau_e}\right) \right)$$

 $f(\mathbf{T})$



Dla ustalonego okna pomiarowego $t_2 - t_1$, sygnał DLTS równy $\delta C = C(t_1) - C(t_2)$ osiąga wartość maksymalną przy pewnej temperaturze. Temu maksimum odpowiada szybkość emisji:

$$\tau_{e,\max} = \frac{t_2 - t_1}{\ln(t_2/t_1)}$$

Sygnał DLTS

Zmiana szerokości okna pomiarowego $\Delta t = t_2 - t_1$, powoduje, że maksimum sygnału DLTS występuje przy innej temperaturze. Ponieważ każdej szerokości okna odpowiada inna szybkość emisji, to powtarzając pomiar C(T) dla różnych szerokości okna pomiarowego, uzyskujemy zależność szybkości emisji od temperatury $e_n(T)$.

Jeśli w próbce jest więcej pułapek, to każdej z nich będzie odpowiadać maksimum sygnału DLTS w pewnej temperaturze.



Metoda lock-in

Sygnał DLTS powstaje po pomnożeniu zmiany pojemności przez funkcję wagową W(t): -1,+1



Dla układu DLS82E gdy sygnał DLTS osiąga maksimum, spełniony jest warunek:

$$e_n(T_{max}) = \frac{2.17}{f_0}$$

DLTS w stałej temperaturze (ICTS)

W tej metodzie temperatura jest stała natomiast zmienia się czas repetycji impulsów depolaryzujących (szerokość okna). Zróżniczkujemy równanie:

$$C(t) = C_0 \left[1 - \frac{n_T(0)}{2N_D} \exp(-\frac{t}{\tau_e}) \right] \qquad t \frac{dC(t)}{dt} = -\frac{t}{\tau_e} C_0 \frac{n_T(0)}{2N_D} \exp(-\frac{t}{\tau_e})$$

To równanie ma ekstremum dla $t = \tau_e$, które wynosi $C_0 \frac{n_T(0)}{2N_D} \frac{1}{e}$. Na podstawie pomiarów dla kilku różnych częstości, można wyznaczyć wykres Arrheniusa $ln\tau_e T^2 = f(\frac{1}{T})$.



Laplace DLTS

Wysoko rozdzielcza spektroskopia Laplace DLTS (w skrócie LDLTS)¹ jest metodą cyfrową, która za pomocą odwrotnej transformaty Laplace pozwala oddzielić emisję pochodzącą z blisko siebie usytuowanych głębokich poziomów defektowych, tym samym pozwala na identyfikację defektów wieloładunkowych, kompleksów itp. LDLTS jest techniką izotermiczną, gdzie zmiana pojemności jest mierzona oraz uśredniona w określonej temperaturze. Funkcja opisująca transformatę

$$f(t) = \int_{0}^{\infty} F(s) \exp(-st) ds$$

gdzie f(t) to zarejestrowana kinetyka pojemności, a F(s) to funkcja gęstości spektralnej czyli widmo sygnału LDLTS, przy czym zakłada się, że f(t) jest to funkcja niewykładnicza, która składa się z wielu funkcji wykładniczych. Idea metody LDLTS polega na określeniu funkcji gęstości spektralnej F(s)z zarejestrowanej kinetyki pojemności f(t). W tym celu wykorzystywane są trzy specjalne algorytmy matematyczne bazujące na metodzie regularyzacji Tikhonova². W wyniku zastosowania tych algorytmów obliczeniowych otrzymuje się sygnał LDLTS, który ma postać funkcji δ Diraca dla kinetyk wykładniczych.

¹L.Dobaczewski i in. J.Appl. Phys. 76, 194 (1994).

². S. W. Provencher, Comp. Phys. Communications 27, 213 (1982).

DLTS i LDLTS - porównanie



DLTS

Technika DLTS pozwala na wyznaczenie następujących parametrów charakteryzujących głęboki poziom:

- energia termicznej aktywacji E_a ,
- koncentracja pułapek N_T ,
- przekrój czynny na pułapkowanie $\sigma_{n(p)}$,
- stan ładunkowy głębokiego poziomu

Pozwala również rozróżnić defekty punktowe od rozciągłych.

Energia aktywacji termicznej

$$e_n = \sigma_n v_{th} N_c \exp(-(E_c - E_T)/kT))$$

Potencjały termodynamiczne:

$$G = H - TS; H = E + pV$$

Energia potrzebna do wzbudzenia elektronu z poziomu pułapkowego do pasma przewodnictwa, jest równa ΔG , więc szybkość emisji:

$$e_n = \sigma_n v_{th} N_c \exp(-\Delta G_n / kT) \quad *$$

gdzie dla T=const: $\Delta G_n = \Delta H_n - T \Delta S_n$

Po podstawieniu do *:

$$e_n = \sigma_n X_n v_{th} N_c \exp(-\Delta H_n / kT)$$

gdzie $X_n = \exp(\Delta S_n/k)$ i może osiągać wartości 10-100. Zatem z wykresu Arrheniusa otrzymuje się entalpię a nie energię aktywacji i efektywny przekrój czynny $\sigma_{n,eff} = \sigma_n X_n$

Koncentracja pułapek

Zmiana pojemności złącza $p^+ - n$ po wyłączeniu impulsu zapełniającego:

$$C(t) = C_0 (1 - \frac{n_T(0)}{2N_D} e^{-\frac{t}{\tau}})$$

$$C(0) = C_0 \left(1 - \frac{n_T(0)}{2N_D} \right)$$

$$C(\infty) = C_0 \left(1 - \frac{n_T(0)}{2N_D} e^{-\frac{\infty}{\tau}} \right) = C_0$$
$$\Delta C = C(\infty) - C(0) = C_0 - C_0 \left(1 - \frac{N_T}{2N_D} \right)$$

$$\frac{\Delta C_c}{C_0} = \frac{N_T}{2N_D}$$

Pomiar amplitudy sygnału DLTS w stanie nasycenia, gdy wszystkie poziomy są obsadzone (po wyłączeniu impulsu zapełniającego)

Przekrój czynny na pułapkowanie

Przekrój czynny nie zawsze jest stały. Defekty, które silnie oddziałują z siecią charakteryzuje przekrój czynny zależny wykładniczo od temperatury:

$$\sigma_n = \sigma_\infty \exp(-E_b/kT)$$



gdzie σ_{∞} - przekrój czynny przy $T \to \infty$, E_b - energia aktywacji przekroju czynnego.

$$e_n = \sigma_\infty X_n v_{th} N_c \exp\left(-\frac{\Delta H_n + E_b}{kT}\right)$$

Silne oddziaływanie oznacza, że zmianie stanu ładunkowego defektu towarzyszy zmiana konfiguracji sieci (tzw. relaksacja sieci) .

Pomiar przekroju czynnego

1. Z wykresu Arrheniusa dla defektów punktowych bez relaksacji sieciowej

2. Z zależności amplitudy sygnału DLTS od czasu zapełniania t_f :

• dla defektów punktowych z relaksacją sieciową¹, korzystając ze wzoru

$$A(t_f) = A_{\infty}(1 - \exp(-t_f c_n))$$

lub korzystając ze wzoru Ponsa² gdy trzeba uwzględnić długość Debay'a:

$$A(t_f) = C_1(1 - \exp(-t_f c_n) + C_2 ln t_f)$$

 dla defektów rozciągłych przekrój czynny jest zależny od stanu obsadzenia pułapek, przy najkrótszych czasach trwania impulsu zapełniającego zapełniane są pułapki o najniższej energii

$$A(t_f) \sim lnt_f$$

¹Hery, Lang Phys. Rev.B 15, 989 (1977), ²Pons, J.Appl. Phys. 55, 3644 (1984)

Defekty punktowe i rozciągłe

Kontinuum stanów, pasmopodobne – zagięcie pasm Prawdopodobieństwo emisji zależy od średniego obsadzenia stanów. Prawdopodobieństwo pułapkowania zależy od bariery na pułapkowanie i od obsadzenia stanów.



Wpływ pola elektrycznego (F) - efekt Poole'a - Frenkla Frzędu 10⁵V/cm







$$\Delta E_{PF} = qV(x_{\text{max}}) = q_{\text{N}} \frac{ZqF}{\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r}$$

$$\Delta E_{PF} = \alpha_{PF} \sqrt{F} \qquad \alpha_{PF} = q_{1} \left(\frac{Zq}{\pi \varepsilon_{0} \varepsilon_{r}} - e_{n}^{PF} = e_{n_{0}} \exp\left(\frac{\Delta E_{PF}}{k_{B}T}\right) \right)$$

$$e_n^{PF} = \sigma_n V_{th} N_c \exp\left(\frac{-(E_a - \Delta E_{PF})}{k_B T}\right)$$

$$E_T(F) = E_a - \Delta E_{PF} = E_a - \alpha_{PF}$$



Zależność emisji termicznej od pola elektrycznego

Przy stałej częstości repetycji $f_0 = \frac{1}{t_0}$ wykonuje się pomiar skanu temperaturowego sygnału DLTS, (tzw. DDLTS) przykładając dwa impulsy o różnym napięciu depolaryzującym złącze (por. rys. obok). Natężenie pola elektrycznego wyraża się wówczas wzorem:

$$F = 1.9 \cdot 10^{-3} \sqrt{\frac{N_D}{\varepsilon_0 \varepsilon_s}} \left[\sqrt{U_{bi} + |U_r|} - \sqrt{U_{bi} + \frac{|U_1| + |U_2|}{2}} + \sqrt{\frac{E_F - E_T}{q}} \right]$$

Zmieniając amplitudę jednego z impulsów od 0 do U_r wyznacza się szybkość emisji w zależności od natężenia pola elektrycznego. Jeśli efekt opisuje model Poole'a-Frenkla, to $lne_n^{PF} \sim \alpha \sqrt{F}$, gdzie α nie zależy od temperatury.

$$\alpha_{PF} = q_{\sqrt{\frac{Zq}{\pi \varepsilon_0 \varepsilon_r}}}$$

Profil koncentracji pułapek

Jeśli szybkość emisji nie zależy od pola elektrycznego (tzn.położenie maksimum sygnału DLTS nie zależy od pola), to korzystając z techniki DDLTS można wyznaczyć profil koncentracji pułapek. W stałej temperaturze mierzona jest zależność amplitudy sygnału DLTS od wysokości jednego z impulsów depolaryzujących przy stałej różnicy napięć depolaryzujących ΔU , od której zależy rozdzielczość techniki. Amplitudę impulsu zmienia się od 0 do wartości bliskiej U_r . W ten sposób skanuje się obszar zubożony w głąb złącza.

Odległość w głąb od powierzchni złącza opisuje zależność:

$$x = \sqrt{\frac{2\varepsilon_s\varepsilon_0}{qN_D}} \left[\sqrt{\frac{|U_1| - |U_2|}{2} - U_{bi} + |U_1|} - \sqrt{\frac{E_F - E_T}{q}} \right]$$

zaś koncentrację pułapek w określonym punkcie warstwy:

$$N_T = 2N_D \frac{\Delta C}{C} \frac{U_{bi} + |U_r|}{\Delta U} \qquad \Delta U = U_1 - U_2$$

Studnia kwantowa i DLTS



- a) Pułapkowanie elektronów
- b) Zagięcie pasm w wyniku pułapkowania elektronów
- c) Emisja nośników po spolaryzowaniu złącza napięciem w kierunku zaporowym

P.Blood, J.W.Orton, "Electrical characterization of semiconductors:majority carriers and electron states", ed. Academic Press (1992)

Układ cyfrowy do pomiaru DLTS i LDLTS (20K-500K)



DLS82E (80-350K)



M.Dąbrowska-Szata, "Spektroskopia Głębokich poziomów w strukturach półprzewodnikowych", ed. PWr (2009)

DLOS i ODLTS



DLOS



$$\left. \frac{dC}{dt} \right|_{t=0} \sim \sigma_{n0} \qquad \left. \frac{dC}{dt} \right|_{t=0} \sim \sigma_{p0}$$